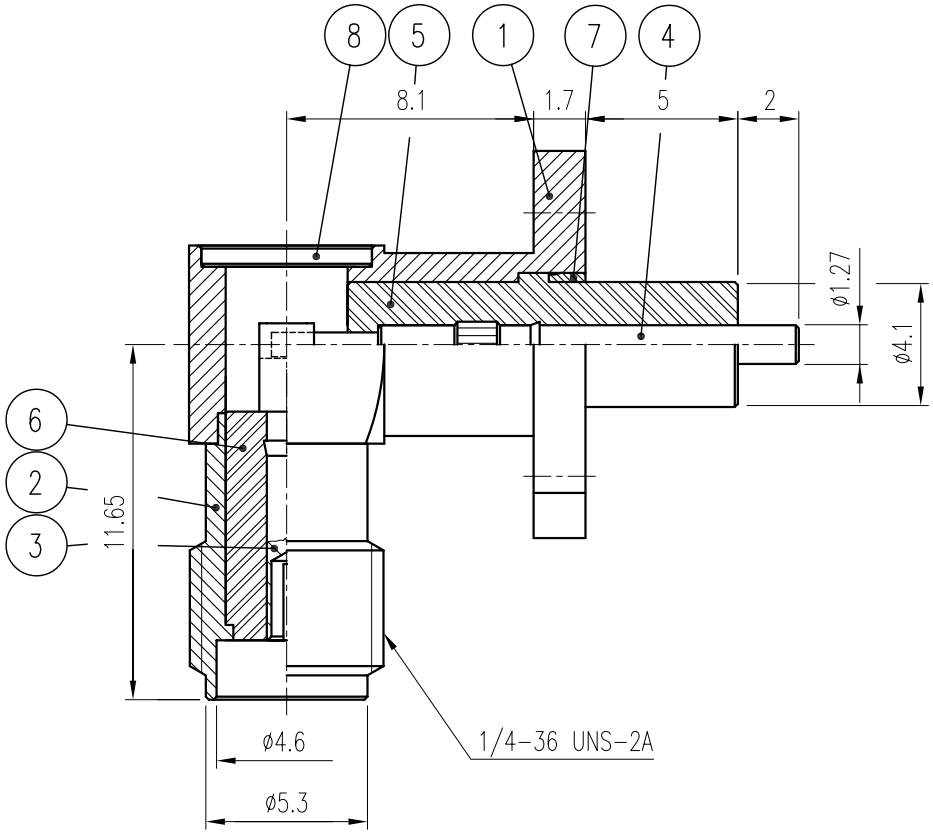
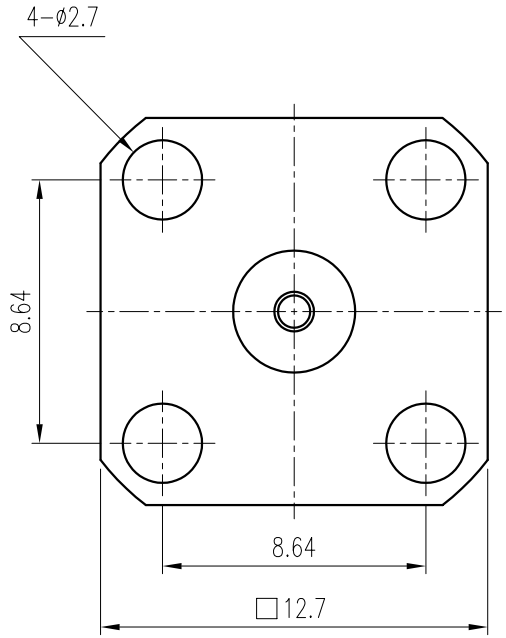
ST \ 가공									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
8	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00038-5/1 (L2048)
7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00037-5/1 (L2047)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01076-N/1 (H2344)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01077-N/1 (H2381)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01165-5/1 (E2569)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01166-5/1 (E2570)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01537-3/1 (D2553B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01535-3/1 (D2553A)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2007. 7. 26.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 —

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-LJ-H4-R VER.0

A4

도번 CN00909-7/1

K314-620-009